

開示の要約

研磨方法および研磨装置

- 5 フラッシュ光源によって発せられる光の強さを安定させることができ、かつより多くの測定点で膜厚を測定しながら基板を研磨することができる研磨方法が開示される。研磨方法は、光学センサヘッドが基板を横切って移動する間に、第1フラッシュ光源および第2フラッシュ光源を異なるタイミングで複数回発光させて、光を光学センサヘッドを通じて基板に導き、かつ基板からの反射光を光学センサヘッド
- 10 を通じて分光器に取り込み、反射光のスペクトルを生成し、スペクトルから基板の膜厚を決定する。

図 4